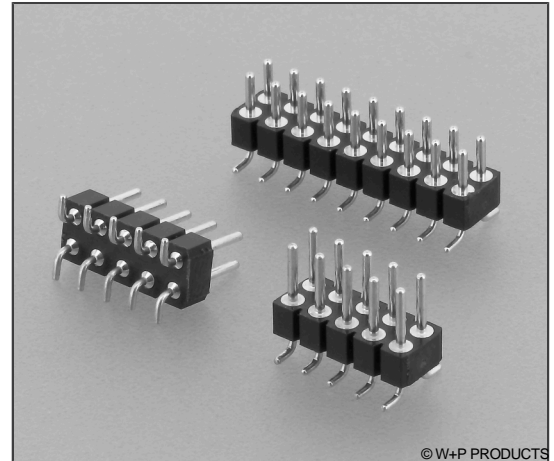


SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 2,54mm, stehend, 2-reihig SMT Precision Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Double Row

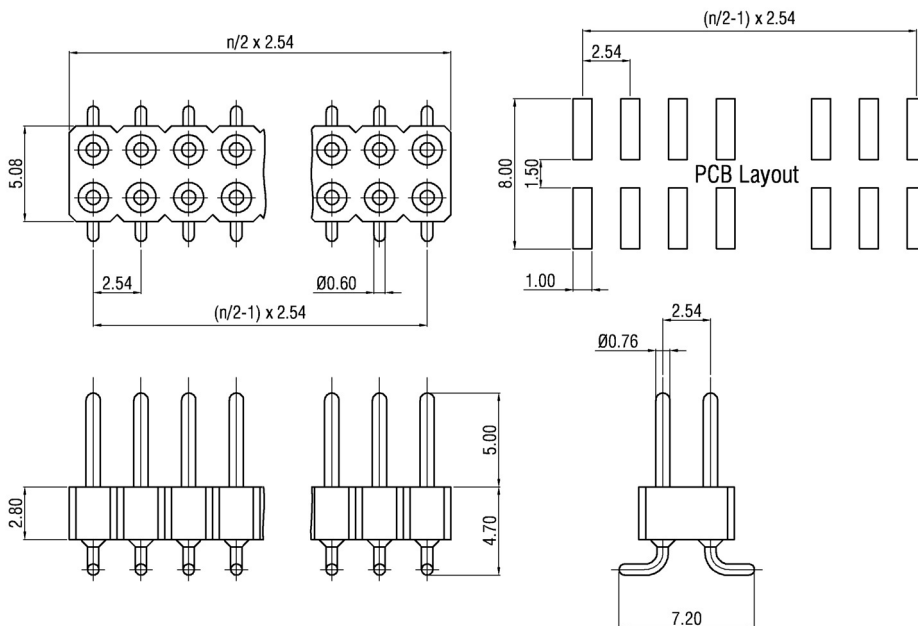
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|--|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Rundkontakt Ø0,76mm, Kupferlegierung <i>Ø0.76mm round contact, copper alloy</i> |
| Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 10 mΩ <i>< 10 mΩ</i> |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i> |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 1 kV RMS <i>1 kV RMS</i> |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3 A <i>3 A</i> |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -55 °C ... +125 °C <i>-55 °C ... +125 °C</i> |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
1531 1532 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series

2132

Contacts*

018

004-072 Zweireihig
Double row

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
10 Vergoldet 0,25µm (Option)
0.25µm gold plated (Option)
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

Packing

ST

ST In Stangen
In tubes

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

